

证券代码：301095

证券简称：广立微

## 杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 线上交流 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	博时基金、易方达基金、广发基金、安信基金、长盛基金、平安基金、诺安基金、国泰基金、招商基金、长城基金、财通基金、真科基金、淳厚基金、东方基金、中加基金、西部利得基金、摩根士丹利基金、创金合信基金、金信基金、民生加银基金、华泰保兴基金、恒生前海基金、九泰基金、路博迈基金管理（中国）有限公司、金鹰基金、格林基金、交银施罗德基金、农银汇理基金、华夏理财有限责任公司、太平资本保险资产管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、中移资本控股有限责任公司、中邮人寿保险股份有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、农银人寿保险股份有限公司、建信养老金管理有限责任公司、平安证券、中信证券、中金公司、中信建投、国信证券、招商证券、瑞穗证券、民生证券、华源证券、瑞银证券、华西证券、万和证券、金元证券、山西证券、平安银行、杭州银行、上海银行、昆仑银行股份有限公司、健顺投资、浦银安盛、润晖、红杉资本、华美国际投资、财通证券资管、长江养老、泰康资产、鹿秀投资、广源信得、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、江西彼得明奇资产管理有限公司、上海国盛资本管理有限公司、深圳市松禾成长基金管理有限公司、润桂投资、上海丰仓股权投资基金管理有限公

	司、广州鼎熙私募证券投资基金管理有限公司、观富（北京）资产管理有限公司、上海中域投资、中国人寿资管、杭州长谋投资管理有限公司、欣平资本、上海复星高科技（集团）有限公司、上海富唐资产管理有限公司、上海混沌投资（集团）有限公司、英大国际信托投资有限责任公司、深圳市正向投资管理有限公司、宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司、大家资管、上海睿郡资产管理有限公司、中信建投自营、北京宏道投资管理有限公司、北京泽瑛私募基金管理有限公司、北京睿策投资管理有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、深圳宽源私募证券基金管理有限公司、长安汇通集团有限责任公司、Manulife Asset Management (Hong Kong) Ltd、DANTAI CAPITAL LIMITED、Infinitey Cap、MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT、Dancheng Investment 等 96 家机构
时间	2025 年 10 月 30 日-2025 年 12 月 31 日
地点	现场交流、公司会议室
形式	现场会议、线上交流
公司接待人员	董秘兼财务总监：陆春龙 证券事务代表：李妍君
交流内容及具体问答记录	<p><b>一、公司概述</b></p> <p>广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司现已形成 EDA 设计软件、WAT 测试设备及半导体数据分析工具相结合的成品率提升全流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。</p> <p><b>二、问答环节</b></p> <p><b>1、请问公司简单说明下 2025 年三季度经营业绩。</b></p> <p>2025 年 1-9 月，公司实现了营业收入 42,769.74 万元，同比</p>

增长 48.86%，归属于上市公司股东的净利润为 3,701.72 万元，同比增长 380.14%。报告期内，公司整体经营保持良好发展态势，公司软硬件业务协同发力，双双实现显著增长。未来，公司将持续专注主营业务，推动技术创新和市场拓展，实现公司高质量的可持续发展。

**2、请问公司今年的研发投入情况如何，当下和未来的研发方向和布局有哪些？**

2025 年 1-9 月，公司研发投入为 22,958.02 万元，占营业收入的比例为 53.68%，同比增长 14.12%。近年来公司研发投入主要用于原有产品和技术的升级迭代、数据分析软件功能模块的完善开发、DFT/DFM 工具的新产品开发等方面。未来，公司将持续秉承自主创新的理念，在制造类 EDA 软件、晶圆级电性测试设备、半导体数据软件系统等方面加强布局，持续提升公司软硬件一体化方案的能力。

**3、请问公司简要介绍一下 2025 年前三季度的研发成果或产品？**

为了保障技术的先进性并巩固和提高公司技术壁垒，公司多年来始终保持高比例的研发投入。2025 年前三季度公司的主要研发成果及发布产品包括：

第一，在 EDA 软件方向，公司持续夯实良率提升与制造类 EDA 的核心竞争力。基于图形匹配的版图检查和验证工具 PatternScan 性能实现大幅提升，达到国际领先水平；DFT 良率分析工具 QuanTest YAD 深度融合 AI 算法，实现了全流程数据的失效根因分析；同时，图形相关工具（Pattern Grouping/PWQ）成熟度进一步增强，市场领先地位日趋稳固；

第二，在数据软件方向，公司正式发布了先进的 SEM/TEM 一站式智能量测平台 iMetrology，并推出了涵盖实验设计与多变量分析的 DE-G DOE 功能以及 DE-G 统计分析软件全功能云端试用版，进一步完善了从数据采集到智能分析的工业软件生态。

第三，在电性测试设备方向，晶圆级老化测试系统——WLBI

	<p>B5260M 正式出厂，硬件品类扩张，从 WAT 测试向可靠性测试领域延伸，产品矩阵进一步丰富，带来新的营收增量。</p> <p>未来，公司将持续加大研发投入，积极进行产业前瞻布局，形成新的业绩增长点以保障公司业务的稳步增长和可持续发展。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。
日期	2025 年 12 月 31 日